

Twin-air[®] ディスペンサ搭載

NEW

レジジン・ペーストコーター



狙いの位置へ、必要量を、無駄なく塗布

パワーデバイス、MEMS、超小型電子部品製造の塗布工程に最適

対応ワーク

- 4～12インチ各種ウエハ (ダイシング・フレーム対応可)
- チップレベル(トレイ搭載)
- ガラス基板、セラミック基板
- 樹脂フィルム、金属基板
- その他各種形状の基板へ対応可

パフォーマンス

- 全面塗布、チップ・マーキング、L/S描画
- ダム構造形成、ドット塗布、局所コート/封止
- エッジカット設定、ノッチを避ける塗布を実現
- 液剤のはみ出し無し～サイド&バックリンス不要
- 塗布領域/パターン形状のCADデータインポート
- 最大膜厚100 μ m、最小50 μ m幅/ Φ 50 μ m

各種液剤への対応

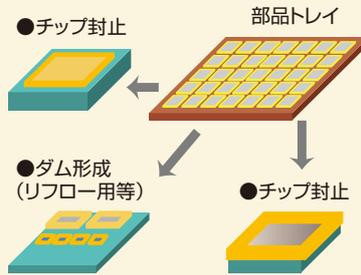
- ポリイミド、高粘度レジスト、その他高粘度液剤
- はんだペースト、ソルダーレジスト、フラックス
- Ag/Cu/Au(ナノ)ペースト、各種導電性ペースト
- エポキシ樹脂、UV硬化樹脂(含、接着剤)

アプリケーション例

ウエハレベル

- 全面コート(ベタ塗)
 - 任意形状コート
 - ダイレベル塗布
 - ライン, ドット(ピラー)
 - ガードリング等
- 拡大イメージ

チップ(トレイ)レベル

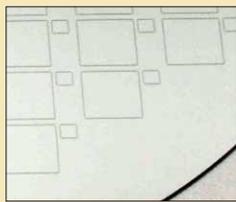


特殊形状への塗布

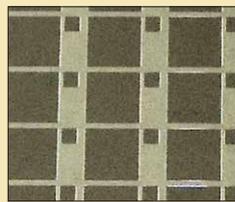
- 部品外周
- ガラス、基板端面
- キャビティ内部
- ホール充填



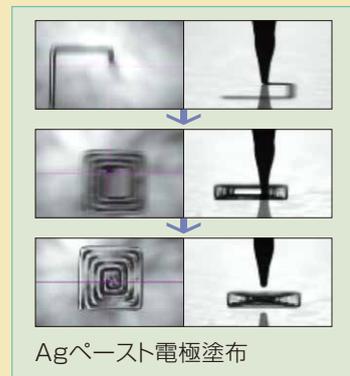
高粘度ポリイミド
全面塗布例
(ノッチ部分)



ポリイミド
100μm幅パターン



レジン液剤で
チップ封止



主な仕様

項目	WLシリーズ(ウエハ,基板レベル)	CLシリーズ(チップ,モジュールレベル)
搭載ディスペンサ	ツインエア方式	
ノズル内径サイズ(μm)	25, 40, 70, 100, 150, 200(標準), 300 ~ 1000(特注)	25, 40, 70, 100, 150, 200(標準) 特注対応可
対応可能基板	6 ~ 12インチウエハ, 300mm角以下の各種基板	300mm角以下の各種形状の基板, 部品搭載トレイ
X-Yステージ駆動	ACサーボモータ ボールネジ, またはリニアモータ	X-Y-Zステージ(ボールネジ)
ローダー / コンベア	オプション(特注対応可)	
プリアライナー	オプション(ウエハ用)	なし
オートアライメント	標準搭載(画像処理アライメント)	
オープン	オプション(ステップベーク対応可)	なし
クーリングプレート	オプション(工場冷却水またはチラー搭載)	なし
検査ユニット	なし	指定の検査ユニット搭載可能(特注対応)
カセット/マガジン	6 ~ 8インチ(オープンカセット), 12インチ(FOUP) 上記以外の基板(特注対応)	要求仕様の特注対応
装置サイズ, 重量	W 2300 x D 1800 x H 2000 2200kg	W 2800 x D 1500 x H 2000 2000kg

●仕様やオプションは、予告なく変更する場合があります。詳細仕様につきましては営業担当までお問合せください。

●デモ、テストや試作を承っておりますので、ご相談ください。

株式会社エンジニアリング・ラボ
Engineering-Lab

- 長野工場 〒390-0843 長野県松本市高宮南8-21
TEL: 0263-88-9611 FAX: 0263-88-8229
E-mail: sales@eng-lab.co.jp
- 本社 東京都北区滝野川7-2-13